

製品・技術発表会のご案内

展示会場内 特設会場

- 参加無料
- 事前申し込み制
(定員になり次第締め切ります)

3月5日水

14:30-15:15

超精密・鏡面加工、機上計測、自動化、脆性材加工を製品開発のテーマに掲げた「研削革命」による研削技術の紹介

- 発表者
技術開発本部 製品開発部
部長 吉田裕

15:30-16:15

～SiCインゴット研削から
ウェハ最終仕上げポリッシュまで～
生産性向上の提案

- 発表者
営業本部 ナノプロセス営業部
国内営業課 岡村亮吾

3月7日金

11:30-12:15

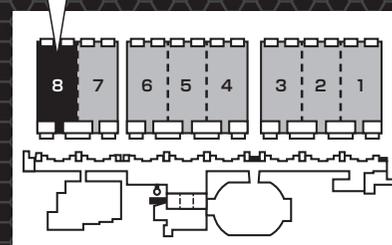
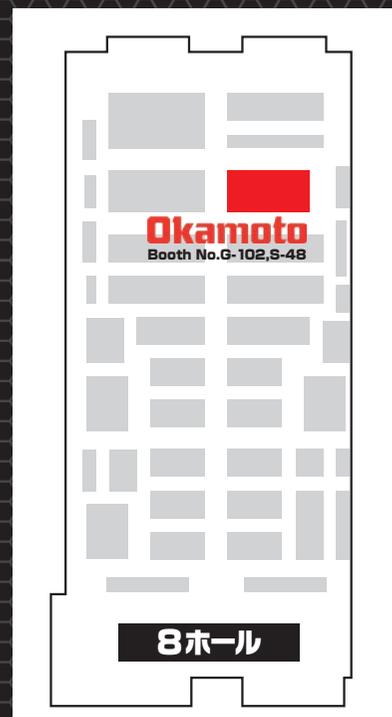
～SiCインゴット研削から
ウェハ最終仕上げポリッシュまで～
生産性向上の提案

- 発表者
営業本部 ナノプロセス営業部
国内営業課 岡村亮吾

— 会場のご案内 —



2025年 幕張メッセ
3月5日水 ▶ 3月7日金



Okamoto

出展のご案内 Booth No.G-102,S-48



GRINDING INNOVATION
2025

TOTAL GRINDING SOLUTIONS

研削盤の総合提案

Okamoto

株式会社 岡本工作機械製作所
<https://www.okamoto.co.jp>

新設展示会

SiC, GaN加工技術展 2025

FOWLP, PLP,
TSVウエーハの研削

次世代高周波通信デバイス用
ハイブリッドウエーハ

BGテープ高精度研削

SiC加工の
トータルソリューション



TOTAL GRINDING SOLUTIONS

研削盤の総合提案



出展製品

グラインディングセンタ
UGM64GC

カタログ



CNC超精密平面研削盤
UPG64CALi

カタログ



CNC精密複合研削盤
UGM360NC

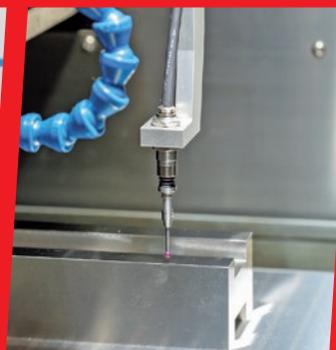
カタログ



超精密・鏡面



機上計測



脆性材



自動化・高能率・複合

